株式の状況（平成20年9月30日現在）

株式数及び株主数

発行可能株式総数	78,000株
発行済株式総数	19,500株
株主数	834名

大株主

	持株数	持株比率
株式会社アルゴグラフィックス	9,900株	50.8%
セイコーインスツル株式会社	4,080株	20.9%
ジーダット従業員持株会	869株	4.5%
石橋　眞一	150株	0.8%
野村證券株式会社	91株	0.5%
株式会社エスケーエレクトロニクス	90株	0.5%
株式会社図研	90株	0.5%
大日本印刷株式会社	90株	0.5%
凸版印刷株式会社	90株	0.5%

所有者別状況

所有者区分	持株数	持株比率
金融機関	104株	0.5%
証券会社	213株	1.1%
その他国内法人	14,343株	73.6%
外国法人等	61株	0.3%
個人・その他	4,479株	23.0%
自己名義株式	300株	1.5%
計	19,500株	100%

株主メモ

上場市場	JASDAQ
事業年度	毎年4月1日～翌年3月31日
定時株主総会	毎年6月
配当基準日	3月31日
株式の売買単位	1株
株主名簿管理人 事務取扱場所	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
公告掲載方法	電子公告とし、次の当社ホームページに掲載します。 （http://www.jedat.co.jp） ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

※お知らせ

平成21年1月より株券が電子化されます。そのため株式に関するお手続に変更がある場合がございますのでご注意ください。詳しくは、下記「電話お問合せ先」にお問合せください。

なお、証券会社等をご利用の場合は、住所変更や買取請求等は引き続きご利用の証券会社等へご連絡願います。未払配当金については、下記「電話お問合せ先」にお問合せください。

	平成20年12月30日まで	**平成21年1月5日より**
郵便物送付先	〒135-8722 東京都江東区佐賀1-17-7	**〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4**
電話お問合せ先 （フリーダイヤル）	0120-288-324（変更ありません）	
取次所	（株主名簿管理人取次所） みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店	**（特別口座管理機関取次所） みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店**
株式取扱手数料	名義書換　無料 新券交付　1枚につき200円	**— （株券が電子化されるためなくなります）**

JEDAT Japan EDA Technologies

本社　東京都中央区日本橋小舟町6-6
Tel　03-5847-0312（代）
URL　http://www.jedat.co.jp

当冊子に関するお問合せ先
株式会社ジーダット　経営企画部
E-mail: corporate.planning1@jedat.co.jp

表紙の絵は、新旧の日本橋の様子です。
かつて、お江戸日本橋が物流の基点であったように、JEDATも、日本橋から日本EDAの最先端技術を世界に発信し続けます。

PRINTED WITH SOY INK
環境に配慮した大豆油インキを使用しています。

JEDAT Japan EDA Technologies

株式会社ジーダット

第7期

上半期　株主通信

自平成20年4月1日　至平成20年9月30日

証券コード：3841

JEDAT
Japan EDA Technologies

JEDAT は
Japan EDA Technologies の略です。

私たちは、日本のEDAのリーダーとして、
電子産業の発展に貢献したいと考えています。

EDA とは
Electronic Design Automation の略です。

電子機器や電子部品の設計作業を支援、検証するソフトウェア（電子系CAD）で、
設計作業には不可欠なツールであり、設計期間の短縮や設計品質の向上を実現します。

株主の皆様へ

代表取締役社長
石橋　眞一

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また当社企業グループの事業活動につきまして、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

当第7期上半期は、第2四半期の急速な景気低迷にもかかわらず、前期来の好調な受注に支えられ、前年同期を大きく上回る業績をあげることができました。しかしながら、未曾有の世界景気低下と円高は、当社顧客企業の業績及び設備投資に重大な影響を与えており、下半期の市場動向は、不透明かつ大変厳しい状況が予想されます。

当社製品・サービスは、ここ数年の継続的かつ高レベルの研究開発投資により、競合に対して優位な位置にあると考えていますが、こうした状況下では、顧客の強い投資抑制に対抗できるだけの顧客における生産性向上及びコスト削減の実現という、さらに高いハードルを越えなければ受注には結びつきません。

当社製品は生産財であり、現下の市況を、顧客の開発コスト削減の機運を強められるチャンスと捉え、従来にも増して、提案型営業及び顧客サポート体制を強化してまいります。

どうか株主の皆様のより一層のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

業績の概要

前年同期比大幅な増収増益

当社は高比率の研究開発を継続し、主力製品「α-SX」の自動設計製品を中心として、顧客毎の設計生産性の向上に直結するような機能強化及びサービス・サポート体制の強化を図ることで競争激化に対応してまいりました。このような取組みの結果、当第2四半期連結累計期間においては、市場環境が極めて厳しい中、前連結会計年度からの受注残も寄与して、当初計画どおり前年同期を大きく上回る業績をあげることができました。当第2四半期連結累計期間の総売上高は1,234百万円となり、営業利益は295百万円、経常利益は322百万円、四半期純利益は215百万円となりました。

半導体市場、FPD市場の区分別でみると、半導体市場につきましては主力製品「α-SX」シリーズの自動設計機能の強化により市場競争力が向上したことで、増設ならびに新規顧客の開拓が進みました。液晶市場につきましては、前年同期と比較すると売上を伸ばしてはおりますが、顧客企業の設備投資が大きく抑制されており、厳しい状況にあります。

製品売上高は、半導体市場での売上増が影響し、大きく売上を伸ばしました。サービス売上高は、保守契約の締結が順調に進み、売上に寄与いたしました。

自社開発製品、代理販売製品の区分でみると、自社開発製品の売上は順調に伸びておりますが、代理販売製品は一部製品が輸入元企業のM&Aの影響等で販売を中止したこと、新規投入製品の市場開拓に予想以上に時間がかかっていること等から、売上が伸び悩んでおります。

このように、当第2四半期連結累計期間の業績は前年同期を大幅に上回る結果となりましたが、当社を取り巻く市場環境は、第3四半期以降一層厳しい状況になるものと予想をしております。

セグメント別売上高

（単位：百万円）

	第2四半期累計期間　前年同期比				平成21年3月期Q1、Q2業績				通期比			
	平成20年3月期		平成21年3月期		Q1業績		Q2業績		平成20年3月期業績		平成21年3月期業績予想	
	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	予想	売上高比
半導体市場	573	62.8%	845	68.5%	549	75.1%	296	59.0%	1,479	69.3%	1,480	65.5%
FPD市場	340	37.2%	388	31.5%	182	24.9%	206	41.0%	656	30.7%	780	34.5%
製品	485	53.1%	772	62.5%	504	69.0%	267	53.2%	1,236	57.9%	1,330	58.8%
サービス	428	46.9%	462	37.5%	227	31.0%	235	46.8%	900	42.1%	930	41.2%
自社開発製品	783	85.8%	1,111	90.1%	670	91.6%	441	87.8%	1,834	85.9%	2,015	89.2%
代理販売製品	130	14.2%	122	9.9%	61	8.4%	61	12.2%	301	14.1%	244	10.8%
合計	914	100.0%	1,234	100.0%	731	100.0%	502	100.0%	2,136	100.0%	2,260	100.0%

四半期連結財務諸表（平成20年4月1日～平成20年9月30日）

四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

科目	当第2四半期末（平成20年9月30日）	前期末（平成20年3月31日）
資産の部		
流動資産	1,832,512	1,894,038
現金及び預金	1,368,987	1,348,367
受取手形及び売掛金	342,322	421,216
たな卸資産	11,785	27,965
繰延税金資産	57,028	56,056
その他	56,089	45,232
貸倒引当金	△3,700	△4,800
固定資産	1,428,173	1,076,873
有形固定資産	25,378	24,845
無形固定資産	44,639	8,252
投資その他の資産	1,358,155	1,043,775
資産合計	3,260,685	2,970,911
負債の部		
流動負債	670,645	561,081
買掛金	90,865	148,788
未払法人税等	123,506	115,204
賞与引当金	86,465	87,790
その他	369,808	209,298
負債合計	670,645	561,081
純資産の部		
株主資本	2,606,192	2,428,836
資本金	760,007	760,007
資本剰余金	890,558	890,558
利益剰余金	988,303	810,948
自己株式	△32,676	△32,676
評価・換算差額等	△16,152	△19,007
その他有価証券評価差額金	△18,310	△21,740
為替換算調整勘定	2,157	2,732
純資産合計	2,590,040	2,409,829
負債純資産合計	3,260,685	2,970,911

四半期連結損益計算書

（単位：千円）

科目	当第2四半期（自 平成20年4月 1日 至 平成20年9月30日）	前中間期（参考）（自 平成19年4月 1日 至 平成19年9月30日）
売上高	1,234,473	914,111
売上原価	325,249	294,521
売上総利益	909,223	619,590
販売費及び一般管理費	613,787	594,072
営業利益	295,436	25,517
営業外収益	27,537	48,889
営業外費用	452	3,051
経常利益	322,520	71,355
税金等調整前四半期（中間）純利益	322,520	71,355
法人税、住民税及び事業税	120,051	28,085
法人税等調整額	△13,286	△ 3,560
四半期（中間）純利益	215,755	46,830

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

科目	当第2四半期（自 平成20年4月 1日 至 平成20年9月30日）	前中間期（参考）（自 平成19年4月 1日 至 平成19年9月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー	408,127	76,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△348,532	△ 827,041
財務活動によるキャッシュ・フロー	△38,400	△ 29,250
現金及び現金同等物に係る換算差額	△575	1,104
現金及び現金同等物の増減額（減少△）	20,619	△ 778,641
現金及び現金同等物の期首残高	1,348,367	1,917,379
現金及び現金同等物の四半期末（中間期末）残高	1,368,987	1,138,737

四半期業績のご報告における適用初年度の対応について

当期から金融商品取引法に基づく四半期報告制度が導入されました。適用される会計基準や用語などが、当四半期に係る財務情報と前年同期に係る財務情報との間で異なりますが、当社といたしましては株主の皆様の利便性を考慮し、当第２四半期決算のご報告においては数値の比較がしやすいよう主要な財務項目は並べて記載することといたしました。

当社の事業戦略

強みを伸ばす：顧客設計期間短縮を追求し、レイアウト設計分野での市場シェア拡大

当社は、日本が得意とする情報家電や自動車向けの電子部品（アナログIC、液晶ドライバ、メモリ等）やFPD等のカスタム設計分野に事業をフォーカスしており、特にその中でも設計下流工程であるレイアウト設計分野では技術的に大きく先行していると考えております。継続的な研究開発投資のもと、カスタム設計分野では実現が非常に難しいとされる自動配置・配線等の設計ツールの性能向上を図り、さらに顧客とのパートナーシップを強化し、これらの自動設計ツールを使いこなすノウハウを蓄積し、自動設計ツールを前提とした新しい設計手法を提案することで、設計期間を従来比で1/3から1/5に短縮することを実現しています。加えて、業界標準化団体への参加による各種標準仕様のサポート、さらには他EDAベンダ製品との円滑な共存環境の構築、半導体メーカの設計ライブラリのサポート等により、当社製品の導入の促進を図っております。以上のような戦略のもと、市場シェアのさらなる拡大を進めてまいります。

強みを活かす：設計上流系の製品強化、海外販売体制の強化による、市場シェアの拡大

当社が強みを持つレイアウト設計分野に加えて、設計上流工程である回路設計等の分野に対しても、高速回路シミュレータ等の戦略製品、さらには設計者を支援するデバッグ・解析ツールなど、今後新製品を投入してまいります。回路設計分野では当社のシェアはまだ小さく、これらの新製品により、当社の強みであるレイアウト設計環境との融合を図ることで、トータルな設計フローのもとでの設計開発期間の短縮、設計品質の向上を実現し、シェア拡大を目指します。また、海外市場につきましては、すでに韓国、台湾、中国等の東アジア地区、米国等に販売代理店を構築しておりますが、一部代理店の見直し、サポート要員の教育強化を行い販売体制の強化に努めております。現在、主に進めているFPD市場だけではなく、半導体市場についても積極的な営業活動を行ってまいります。

トピックス TOPICS

JEDAT EDA Fair 2008 開催

2008年10月15日（大阪会場）、17日（東京会場）において、当社のプライベートショウ“JEDAT EDA Fair 2008”を開催いたしました。今年は、『設計改革、新たなステージへ』をメインテーマとして、お客様の設計環境をこれまでとは異なった新たなアプローチで改革すべく、当社のグローバル化の方針、他社との提携による新しい設計環境の構築、そして多数の新製品のご紹介を行い、大盛況の2日間でした。

特にトヨタグループ、東芝グループのユーザーによる、当社のツールを用いた設計手法の事例発表は、ジーダットの新しい自動設計手法を採用したことによって大幅に設計期間を短縮し設計効率を上げた成功例として、来場者から非常に大きな反響があり、後日日経BP社のサイトでもその内容が採り上げられております。

セミナー会場の様子

デモンストレーション会場の様子

シリーズ　ジーダットの設計ツール　NEW

Mosla（モスラ）

～アナログIC向け　レイアウトプロトタイピングツール（ソフトウェア）～

ICは、素子（トランジスタや抵抗など）の配置と素子間の配線によって設計されますが、アナログICの場合は、素子の配置された場所や、素子間の配線の引き回しが、できあがったICの動作に大きく影響します。ICの品質を向上させたり設計工数を短縮するためには、設計の早期（回路設計の段階）で、高精度な概略のレイアウト結果を確認し、その影響の度合いを把握しておくことが重要です。このように、回路を設計する段階で素子の配置や配線（レイアウト）を試しに行ってみることを、「レイアウトプロトタイピング」と呼びます。

Moslaは、レイアウトプロトタイピングを、ボタン１つで手軽に行うことができるツールです。回路設計者はMoslaを使用することによって、時間をかけて素子の配置や配線を試行錯誤することなく、極めて簡単に、精度の高いレイアウト結果を確認することができ、設計の工数を大幅に短縮することができます。

回路図　プロトタイピング結果

FineAcres（ファインアクレス）

～液晶パネル向け高精度配線抵抗計算ツール（ソフトウェア）～

液晶パネルは小さな画素を配線で接続して作られていますが、それぞれの画素に接続している配線の抵抗値が正確に均一でないと、画面に表示ムラができてしまいます。そのため液晶パネルの設計者は、各配線の抵抗値を均一にするために、設計の段階で１本１本の配線の抵抗値を計算していました。ところが液晶パネルの配線は太さが一定でない上に極めて長いため計算が複雑であり、限られた時間の中でそれらの抵抗値を正確に計算することは非常に困難でした。

当社はこのようなニーズに応えるべく、液晶パネル向け高精度配線抵抗計算ツールFineAcresを世界に先駆けて開発しました。FineAcresは極めて高い精度で短時間に抵抗値を計算することができるツールで、現在多くの液晶パネル設計者に使われています。

回路図

会社概要（平成20年9月30日現在）

商号	**株式会社ジーダット（Jedat Inc.）**
所在地	〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町6-6
代表者	代表取締役社長　石橋　眞一
営業開始	平成16年2月2日
資本金	760,007,110円
事業内容	電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等設計支援のためのソフトウェア開発・販売およびコンサルテーション
関連会社	**株式会社ジーダット・イノベーション（Jedat Innovation Inc.）** 福岡県北九州市若松区ひびきの2-5 情報技術高度化センター **績達特軟件（北京）有限公司（Jedat China Software Inc.）** 北京市西城区新街口外大街28号B座409-412室 URL http://www.jedat-soft.com.cn **株式会社Ａ－ソリューション（A-Solution Inc.）** 東京都中央区日本橋小舟町6-6 URL http://www.a-solutioninc.com
所属団体	社団法人　電子情報技術産業協会（JEITA） 社団法人　日本半導体ベンチャー協会（JASVA） 有限責任中間法人 日本エレクトロニクスショー協会（JESA） 日本EDAベンチャー連絡会（JEVeC）

役　員（平成20年9月30日現在）

代表取締役社長	石橋　眞一	
取締役	増山　雅美	（経営企画部長）
取締役	山城　治	
取締役	香月　弘幸	（システム部長）
取締役	藤澤　義麿 ㈱アルゴグラフィックス 代表取締役会長執行役員 兼 CEO）	
取締役	中村　隆夫 ㈱アルゴグラフィックス　執行役員）	
取締役	平田　喜信 （セイコーインスツル㈱　取締役常務執行役員）	
常勤監査役	飯村　雄次	
監査役	吉田　隆男	
監査役	伊藤　俊彦 ㈱アルゴグラフィックス　執行役員）	